

# 最先端LSIテスト基板

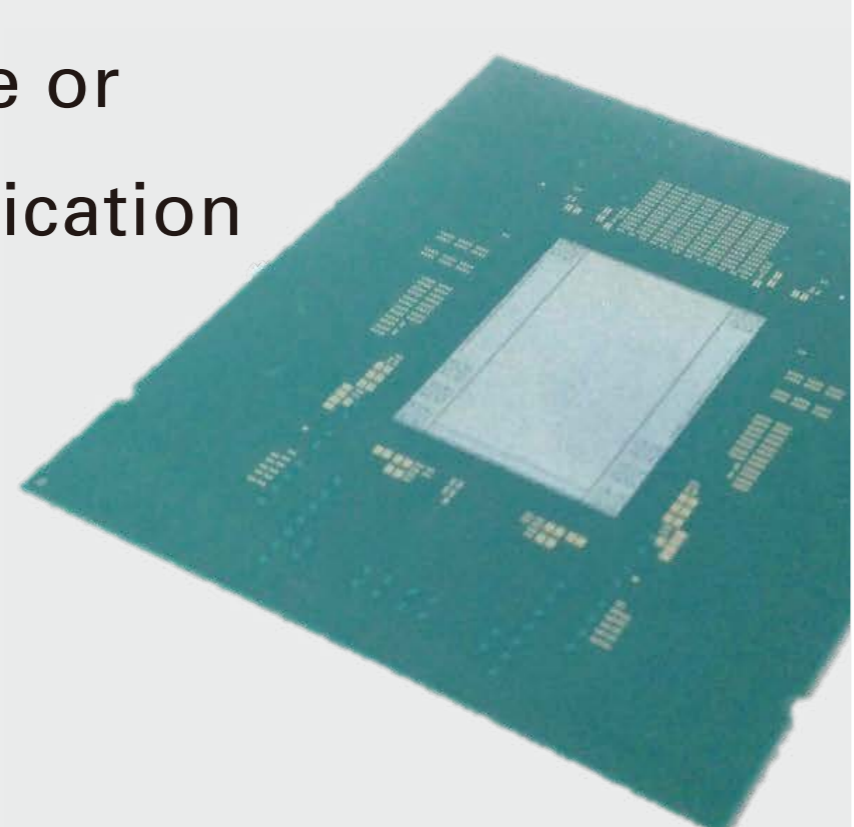
Advanced LSI test board

## FC-BGAと超高多層の基板技術が実現するチップテスト基板


### 高性能 Space Transformer 基板

#### Large FC-BGA substrate

Large Substrate Suitable for Large Die or Chiplet Application  
>100mm $\square$

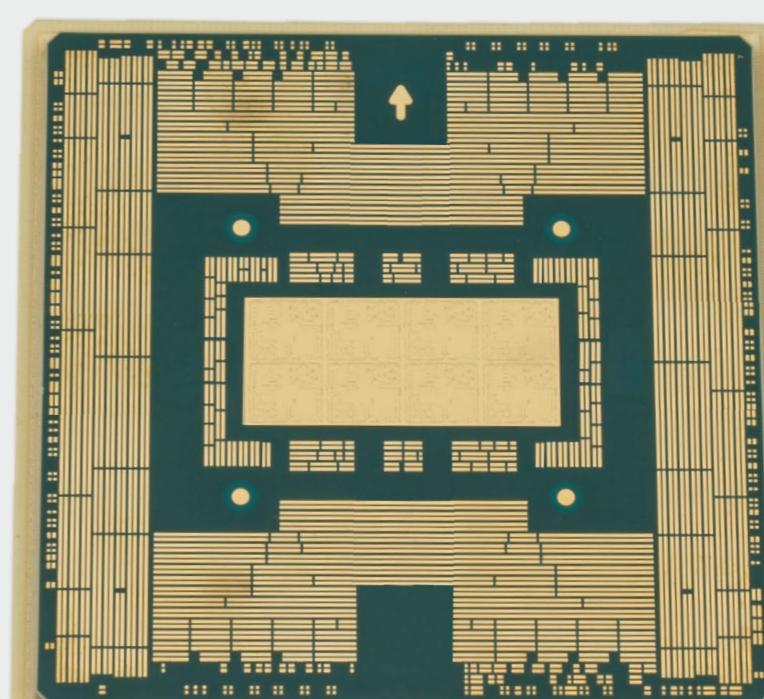
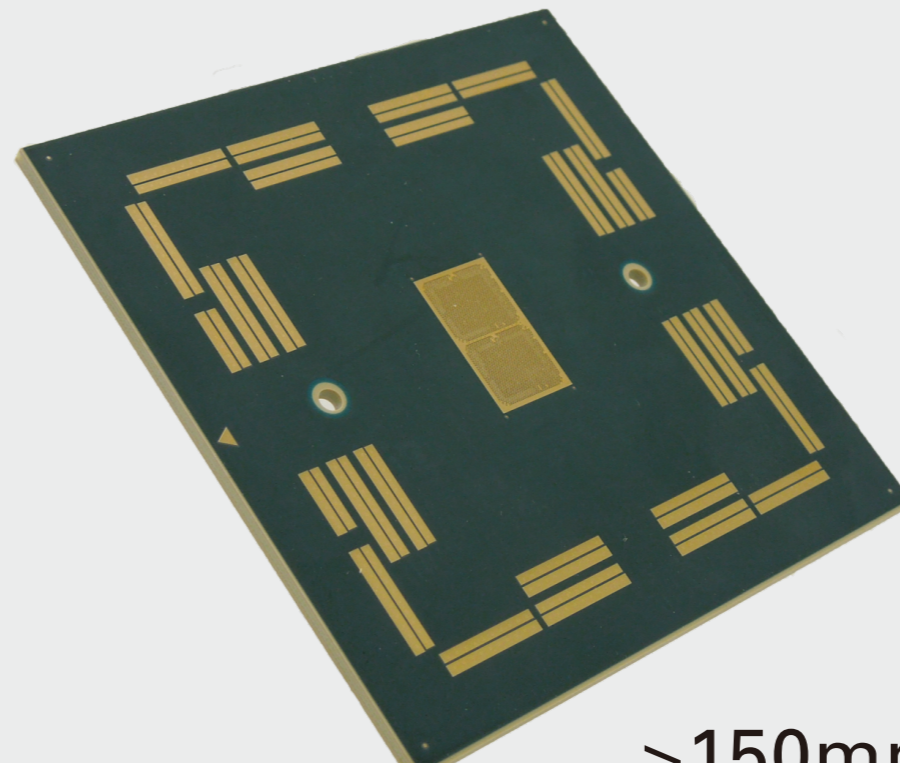


SAME TECHNOLOGY APPLIED



#### ST BOARD

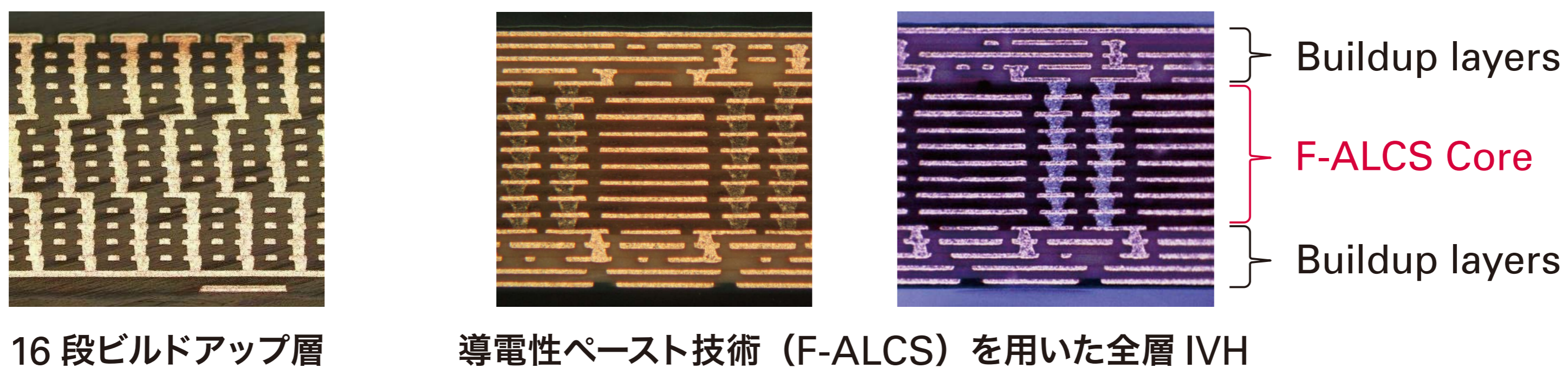
Features  
>150mm $\square$  size of 16-n\*-16 buildup substrate is available.



\*... n: Core layer

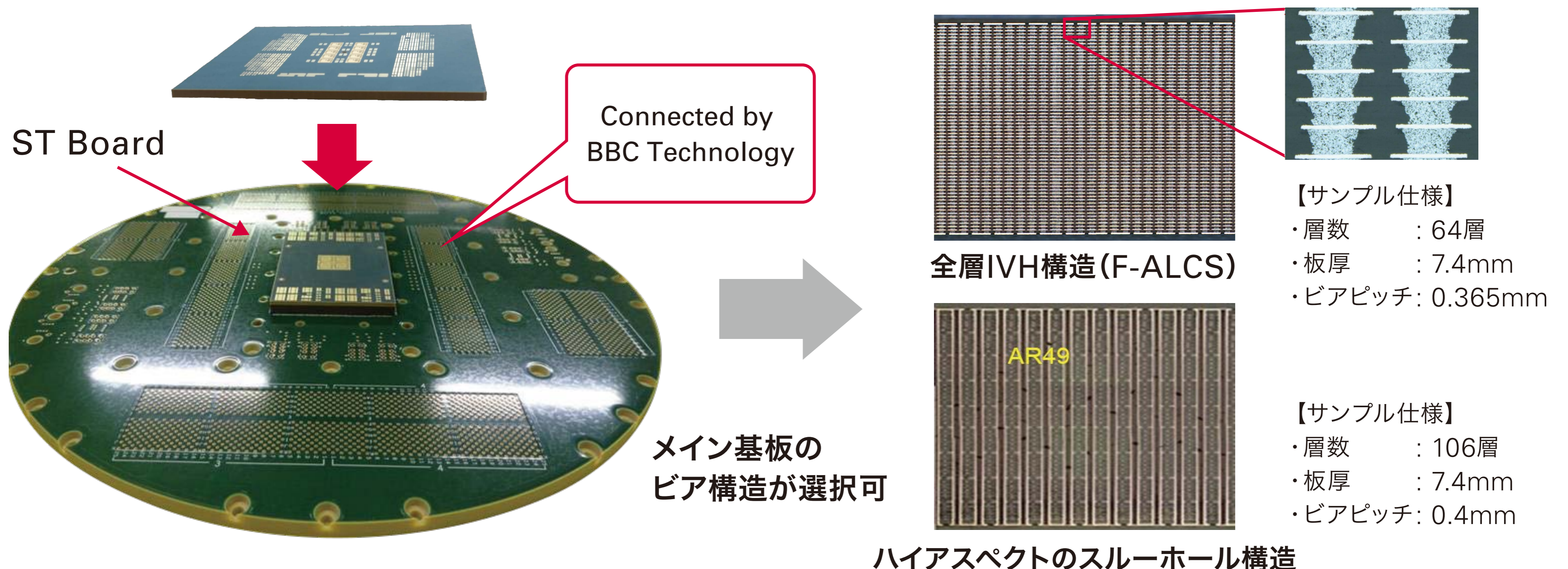
#### FC-BGAのSAP\*技術をベースとした多段ビルドアップ構造

\*... Semi Additive Process



### ST基板と超高多層基板の融合構造

- FC-BGA基板技術と超高多層基板技術の複合構造実現
- 超高多層+超ハイアスペクトの構造に適したビア構造の選択



ST Board

Connected by BBC Technology

メイン基板のビア構造が選択可

全層IVH構造 (F-ALCS)

【サンプル仕様】  
・層数 : 64層  
・板厚 : 7.4mm  
・ビアピッチ: 0.365mm

AR49

【サンプル仕様】  
・層数 : 106層  
・板厚 : 7.4mm  
・ビアピッチ: 0.4mm

ハイアスペクトのスルーホール構造

